

上周英偉達 CEO 黃仁勳正式宣佈公司進軍 PC 處理器市場，發佈面向 Windows 平臺的 RTX Spark 系統級晶片，推動 AI 能力從雲端數據中心向個人終端下沉。市場普遍看好 AIPC 賽道長期成長前景，核心邏輯有三：一是 AIPC 產業進入全新發展週期，端雲協同模式加速落地；二是端側 AI 滲透率持續攀升，硬體升級與應用生態爆發共同驅動行業高景氣；三是算力下沉疊加統一生態構建，帶動產業鏈多環節迎來價值重估。目前機構普遍聚焦 AIPC 核心產業鏈，重點看好 Arm 架構 SoC 晶片、高端高頻 PCB、高帶寬存儲、ODM 整機代工及面板顯示等五大核心方向。隨著英偉達 N1/N1X 系列晶片持續賦能與微軟 AI 生態不斷完善，端側算力升級與整機價值量提升將同步推進，國產供應鏈將深度受益於訂單放量與技術迭代帶來的雙重紅利。

英偉達入局重塑 PC 生態，AIPC 產業鏈有望迎來價值重估？

6 月 1 日英偉達 GTC 大會上，黃仁勳的主題演講再次震撼全球計算產業。隨著 RTX Spark 超級晶片（內部代號 N1X）正式亮相，這家全球市值最高的 AI 巨頭，正式吹響了進軍個人電腦核心處理器市場的號角。黃仁勳直言，這將是 "PC 行業 40 年來首次徹底的重新設計與再造"。

英偉達入局 PC 領域絕非簡單的橫向業務擴張，而是其構建 "端雲一體"AI 生態的決定性戰略落子。黃仁勳曾將 AI 產業比作 "五層蛋糕"，英偉達已牢牢掌控最核心的晶片層（GPU），並持續向上遊基礎設施層延伸。此次發佈的 N1X 晶片，創新性地集成了 Blackwell 架構 GPU 與 Arm 架構 Grace CPU，本質是將其在數據中心驗證成熟的 "GPU 加速計算+統一記憶體"技術範式，完整下沉至消費級終端市場，核心目標是搶佔 "智能體 AI (Agentic AI)" 的本地入口。隨著 AI 從生成式對話向自主執行任務的智能體演進，市場對低延遲回應、數據隱私保護和本地算力自主可控的需求正呈爆發式增長。值得注意的是，就在本次發佈會前兩天，微軟、英偉達、Arm 已聯合發佈 "PC 的新時代 " 預告，三方生態協同為 N1/N1X 晶片的商業化落地鋪平了道路。

當前機構普遍看好 AIPC 賽道的中長期成長前景，核心邏輯包括三點：一是 AIPC 已進入技術與產品雙輪驅動的新週期，端雲協同架構加速落地；二是端側 AI 滲透率持續快速抬升，硬體迭代升級與 AI 應用爆發將共同驅動行業高景氣；三是算力下沉與統一生態構建，將帶動 PC 產業鏈多個環節迎來價值重估。



圖一：英偉達 RTX Spark 超級晶片亮相



資料來源：COMPUTEX 2026 (臺北國際電腦展)

► COMPUTEX 2026：全球 AI 大咖齊聚，AIPC 成主角

6月1日至5日，2026年國際電腦展 (COMPUTEX 2026) 在臺北盛大舉行，本屆展會以 "AI Together" 為核心主題，吸引了英偉達、AMD、英特爾、高通、Arm 等全球科技巨頭參展，規模創歷史新高。展會期間，AIPC 成為全場焦點。各大廠商紛紛發佈最新的 AIPC 產品與技術，其中最具震撼力的當屬英偉達創始人兼 CEO 黃仁勳發佈的 RTX Spark 超級晶片。黃仁勳在主題演講中表示："過去四十年裏，人們通過點擊和打字來操作電腦，而有了 RTX Spark 和 Microsoft Windows，用戶只需提出需求，PC 就會自動完成工作。這是四十年來，第一次對 PC 產品線進行全方位、顛覆性的重新設計。"

*端雲協同加速落地，AIPC 迎來黃金發展新週期

英偉達聯合微軟、Arm 正式發佈新一代 Arm 架構 PC 平臺，終結了高通在 Windows on Arm 生態的獨家壟斷地位，標誌著 AIPC 產業生態從單一廠商主導，正式邁入多強共建的全新發展階段。RTX Spark 的核心創新在於首次將企業級 Blackwell GPU 深度集成於 PC 處理器中，並通過 NVLink-C2C 技術實現 CPU 與 GPU 的高速互聯。同時，128GB 的統一記憶體架構使得大模型能夠在本地流暢運行，為個人 AI 智能體的普及奠定了硬體基礎。憑藉極致的能效比優勢，徹底解決了傳統 x86 架構高功耗的行業痛點，完美適配大記憶體、低功耗的端側 AI 計算場景。與此同時，微軟 Copilot+PC 生態持續完善，驅動本地 AI 推理需求呈爆發式增長，複雜智能體 (Agent) 任務已可直接在端側運



行，大幅降低了對雲端算力的依賴。業內普遍認為，此次三方生態深度聯動將顯著提升端側算力供給能力、優化系統級運行效率，推動 AIPC 從早期概念滲透加速進入規模化落地階段，成為端雲協同產業發展的核心增量來源。

在性能優勢上，與傳統 x86 平臺相比，英偉達 RTX Spark 晶片在多方面具備顯著優勢：其 1PF 的端側 AI 算力達到當前主流 x86 AIPC 的 3-4 倍，可流暢運行更大規模的本地大模型；採用 128GB 統一記憶體架構，解決了傳統 PC 中 CPU 與 GPU 記憶體分離的痛點，大幅提升大模型推理效率；依託英偉達完整 CUDA、TensorRT 等 AI 軟體生態，開發者能夠將數據中心的 AI 應用無縫遷移至端側；同時基於 Arm 架構的 CPU 在能效比上擁有天然優勢，可在輕薄本形態下實現高性能 AI 計算。不過 x86 陣營並未坐以待斃，英特爾與 AMD 均計畫於今年下半年推出新一代 AIPC 處理器，進一步加碼端側 AI 算力，未來 PC 市場將正式形成英偉達- Arm 與英特爾- AMD 兩大陣營分庭抗禮的競爭格局。

圖二：英偉達 RTX Spark 超級晶片性能



資料來源：COMPUTEX 2026 (臺北國際電腦展)



***AIPC 市場規模與前景：從概念走向主流，市場空間廣闊**

AIPC 是內嵌 NPU (神經網路處理單元) 算力、支持端側大模型運行的下一代個人電腦，隨著 AI 技術快速迭代與硬體成本持續下探，正加速從概念驗證階段走向規模化普及。多家權威機構一致預測，2026 年將成為 AIPC 大規模普及的關鍵拐點：Gartner 數據顯示，2026 年全球 AIPC 出貨量將達 1.43 億臺，市場滲透率從 2025 年的 31.0% 躍升至 54.7%，首次超越傳統 PC 成為市場主流；Canalys 數據顯示，2024 年全球 AIPC 滲透率僅有 18%，行業仍處在產業化起步週期，預計 2028 年滲透率抬升至 70%，對應產品銷量年化複合增速可達 44%，行業增長彈性突出。

AIPC 市場爆發式增長的核心驅動力來自技術突破、需求升級與政策支持的三重共振。端側 AI 算力實現跨越式提升，以英偉達 RTX Spark 為代表的新一代 AIPC 晶片將端側算力推至 PF 級別，使本地運行千億參數大模型成為現實；個人 AI 智能體需求持續爆發，能夠自動執行複雜任務的智能體大幅提升工作效率，成為用戶換機的核心動力；同時微軟、Adobe、Blender 等主流軟體廠商紛紛完成旗下應用的 AI 重構，為 AIPC 提供了豐富的落地場景；政策層面，國務院《關於深入實施“人工智慧+”行動的意見》明確將 2026 年列為 AI 終端普及關鍵推進期，提出 2027 新一代智能終端（含 AIPC）普及率達 70% 的目標，為產業發展提供了堅實保障。

當前 AIPC 仍處於“AI 加持”的初級發展階段，本質是在傳統 PC 功能基礎上疊加 AI 輔助能力。未來 AIPC 將全面向“AI 原生”方向演進，整個產業的硬體架構與軟體生態都將圍繞 AI 進行系統性重構：硬體層面，CPU、GPU、NPU 將深度融合形成統一的 AI 計算架構；交互層面，將從傳統的點擊、打字模式轉變為自然語言交互；應用層面，AI 智能體將成為核心應用形態，用戶可通過智能體完成絕大多數任務；安全隱私層面，本地 AI 計算將成為主流趨勢，從根本上保障用戶數據的安全與隱私。

圖三：AIPC 為 AI 大模型應用之一

自然语言交互的个人智能体 - 多模态自然语言交互 UI - 基于本地大模型的个人智能体		内嵌个人大模型 - 本地为主，边缘与云为辅的大模型 - 个性化本地知识库
标配本地混合 AI 算力 - CPU&NPU&GPU 本地混合计算架构 - 个人终端和家庭主机 / 企业边缘主机协同计算	开放的 AI 应用生态 - AI 原生应用、AI 赋能应用 - 能够被智能体任务调度、适配混合 AI 算力平台等	设备级个人数据 & 隐私安全保护 - 本地隐私推理 & 非敏感任务调用云端大模型 - 硬件级安全芯片保护 & 个人数据加密 / 脱敏传输

資料來源：AI PC 產業白皮書



► 投資者應該關注行業內哪些投資機會？

AIPC 正迎來黃金發展新週期，其中端側算力升級驅動的硬體替換潮是當前確定性最強的第一增長曲線。全球主流 PC 廠商加速 AIPC 產品佈局，截至 2026 年 Q1 已發佈的 AIPC 機型超 200 款，Gartner 預測 2026 年全球 AIPC 出貨量將達 1.43 億臺，滲透率從 2025 年的 31.0% 躍升至 54.7%，首次超越傳統 PC 成為市場主流。端側 AI 算力的跨越式提升是行業爆發的核心驅動力，以英偉達 RTX Spark 為代表的新一代 AIPC 晶片將端側 AI 算力推至 1PF 級別，較上一代產品提升 10 倍以上，使本地運行千億參數大模型成為可能；同時 AIPC 平均售價從 2024 年的 1200 美元降至 2026 年的 800 美元左右，成本下探為大規模普及掃清了障礙。另一方面，端雲協同的智能體經濟作為 AIPC 技術的核心應用延伸，正迎來技術與需求的雙重紅利，隨著微軟、英偉達、Arm 聯合發佈 PC 智能體標準，個人數字助理、企業智能辦公、工業智能運維等場景將加速落地，預計未來 5-10 年中國端側智能體經濟市場規模將快速增長。

投資機會方面，建議重點關注 AIPC 產業鏈核心環節的龍頭標的：整機 ODM 環節，龍頭華勤技術(603296.SH)已率先完成英偉達、英特爾、AMD、高通四大主流平臺全覆蓋，適配能力行業領先，其深度綁定聯想、戴爾、惠普等全球頭部 PC 廠商；上游晶片端，國內 MCU 龍頭兆易創新(3986.HK)前瞻佈局端側 NPU 晶片，有望受益於端側 AI 算力需求爆發；顯示與交互環節，全球前二面板龍頭京東方 A(000725.SZ)、TCL 科技(000100.SZ)將充分享受 AIPC 顯示升級帶來的增量需求；結構件環節，全球消費電子結構件龍頭藍思科技(6613.HK)是 AIPC 玻璃及金屬結構件的核心供應商；整機品牌端，與英偉達深度合作的聯想集團(0992.HK)是 AIPC 轉型的核心受益方。

免責聲明：本報內容所提供資料所述或與其相關的任何投資或潛在交易，均受限於閣下司法轄區適用的法律及監管規定，而閣下須單獨就遵守該等法律及監管規定負責。本報內容僅供參考，不構成任何投資建議。本公司對所提供的財經資訊已力求準確，但對其中全部或部分內容的準確性、完整性或有效性，不承擔任何責任或提供任何形式保證。如有錯失遺漏，本公司恕不負責。另請注意證券與虛擬資產價格可升可跌，尤其虛擬資產的風險極高，投資者應對有關產品保持審慎及自行承擔投資風險。

